산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 6. 26.(월) 14:00 < 6.27.(화) 조간 > 배포 2023. 6. 26.(월)

반도체 소부장, 팹리스 유니콘 육성을 위한 『반도체 생태계 펀드』 출범

- '22.7월 발표한 『반도체 초강대국 달성전략』 이행 차원, 총 3천억원 규모 조성

메모리 중심의 국내 반도체 밸류체인을 시스템 반도체 및 소부장으로 확장하기 위한 금융지원책으로서, 총 3천억원 규모의 『반도체 생태계 펀드』가 본격 조성된다.

금번 펀드는 현재 운용 중인 반도체전용펀드의 높은 자금소진율*을 고려하여, 기존 펀드 대비 최대규모(3천억원)로 조성된다. 또한, 프로젝트 투자규모**를 기존 펀드 보다 상향하여 유망 팹리스·소부장 기업의 스케일업을 뒷받침하고, 인수합병(M&A) 활성화를 통한 기술고도화 등을 적극 지원할 계획이다. 펀드 운영은 한국성장금융에서 맡게 되며 향후 하위펀드 위탁운영사 선정 절차 등을 거쳐 연내에 투자를 개시할 예정이다.

* '23.6월 기준, 『반도체성장펀드('17년 조성, 약 2,400억원)』 90.5%, 『시스템반도체상생펀드('20년 조성, 약 1,200억원)』 56.2% → '24년 소진 전망

** 다수기업에 대한 소규모 지분투자외, 큰 규모의 자금을 단일 기업에 집중 투자하는 방식

산업통상자원부는 6.26.(월) 『반도체 생태계 펀드』 출범을 위한 업무협약(MOU) 체결식*을 개최하였다고 밝혔다. 체결식에 참석한 산업통상자원부 장영진 제1차관은 "정부는 갈수록 치열해지고 있는 글로벌 반도체 주도권 경쟁을 전시상황으로 인식하고, 경쟁국에 뒤처지지 않는 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다"며, "반도체 투자 활성화를 위한 투자세액공제 상향, 용적률 완화 특례 도입, 시스템 반도체 경쟁력 강화를 위한 300조원 규모의 첨단 시스템 반도체 클러스터 조성, 팹리스·소부장 국산화를 위한 신기술 테스트베드로서 첨단반도체기술센터(ASTC**) 구축 등 전례 없는 지원책을 추진하고 있다"고 강조했다.

* 참여: (정부) 산업부, 금융위, (민간) 삼성전자, 하이닉스, 성장금융, 반도체산업협회, 산업은행, 기업은행 등

** Advanced Semiconductor Technology Center

아울러, "오늘 출범하는 『반도체 생태계 펀드』는 최근 금리인상, 업황 악화 등으로 투자자금 조달에 애로가 발생하고 있는 팹리스·소부장 기업의 성장과 자립화를 위한 것으로, 이번 펀드가 미래 반도체 산업을 이끌 한국형 엔비디아 탄생의 마중물이 될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

업무협약(MOU) 체결식에 이어, 장영진 차관은 금융위 부위원장과 함께 팹리스·소부장 기업의 금융애로 청취를 위한 간담회를 주재하였으며, "금융위와 긴밀한 협력을 통해 전도유망한 반도체 스타트업, 중견중소기업에 대한 금융지원을 강화해 나가겠다"고 언급했다.

담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	류종민 (044-203-4272)

新성장 4.0 상상을 현실로 대한민국 정책브리핑 OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참 고 『반도체 생태계 펀드』 MOU 체결 및 반도체 금융애로 간담회 계획

1. 추진 배경

□ **시스템 반도체(팹리스) 및 소부장 경쟁력 강화**를 위해 관련 유망 기업 스케일업을 위한 『**반도체생태계펀드**』 **조성** 발표*

* 『반도체 초강대국 달성전략』('22.7)
- 발표내용: 반도체 소부장 등 집중투자 위한 3,000억원 규모 '반도체 생태계 펀드' 조성 (`23년~)

○ 펀드 조성 위한 관계기관 협의를 거쳐 **MOU 체결 통해 공식 출범**

- (**조성규모**) 3,000억원 ※ 모펀드 1,500억원+민간투자자 1,500억원
  * 모펀드: 기업 750억원(삼성전자, 하이닉스) + 정책금융 750억원(성장금융, 산업은행, 기업은행)
- (**투자내용**) 반도체 소부장·팹리스 대상 스케일업, M&A 투자 등 실행

□ MOU 체결 이후 **반도체 업계의 금융애로 파악 및 지원정책 발굴**을 위한 **산업부-금융위 공동주재 "반도체 금융지원 간담회"** 개최

2. 개최계획

□ (**일시/장소**) '23.6.26(월) 14:00~15:10 / 서울 YWCA 회관 4층 대회의실(서울 명동)

□ (참석) 정부**산업부 제1차관·금융위 부위원장**, 기업**삼성전자·SKH·DB하이텍·원익QnC·실리콘아츠·TEMC 등 6개사**, 기타**반도체산업협회 부회장, 한국성장금융 대표, 산업은행 부행장, 기업은행 부행장 등**

□ (내용) ①『반도체 생태계 펀드』 MOU 체결식, ②반도체 금융지원 업계 간담회

소요시간	주요내용	비고
10'	**모두발언**	· 산업부 제1차관, 금융위 부위원장
10'	**반도체 전용펀드 운용현황 및 신규펀드 내용 발표**	· 한국성장금융 대표
15'	**반도체 생태계 펀드 MOU 체결식** * MOU 체결 당사자: 삼성전자, 하이닉스, 한국성장금융, 산업은행, 기업은행, 반도체산업협회 등 6개 기관	
35'	**반도체 금융지원 간담회**	· 산업부 제1차관, 금융위 부위원장 공동 주재